

快克智能(603203)公司深度研究——

焊接设备细分龙头，AI驱动成长边界拓展

证券分析师：张世杰(分析师)

证券分析师：罗平(分析师)

分析师登记编号：S1190523020001

分析师登记编号：S1190524030001

报告摘要

- **公司概况：焊接设备细分龙头，扩展产品品类及应用布局。**公司创立于1993年，是一家专业的智能装备供应商，2015-2024年营收由2.30亿元增长至9.45亿元，CAGR高达17.00%公司的主要产品包括：智能制造成套设备、精密焊接装联设备、机器视觉制程设备、固晶键合封装设备。聚焦半导体封装、新能源汽车电动化和智能化、智能终端智能穿戴、精密电子（医疗电子、数据通信）等多个行业应用领域。近年来，公司积极把握AI智能硬件产品带来的市场机会，加大技术创新和国际化布局，深度布局AI人工智能、智能穿戴、半导体封装、新能源汽车及储能、机器人电子元件等战略赛道，精密焊接装联设备和AOI机器视觉设备实现增长。
- **受益3C产品创新、自动化、出海趋势，助力主业实现高速增长。**在消费电子领域：消费电子AI化进程显著加速，硬件终端智能化迭代节奏加快。公司精准把握AI消费电子结构升级机遇，技术创新与业务拓展同步突破。在智能终端和智能穿戴领域，公司激光热压、锡丝、锡环、锡球焊等工艺设备精准把握消费电子结构升级机遇，已在A客户、小米、华勤技术等头部企业应用落地；公司为莫仕提供了高速连接器精密组装设备，进入英伟达供应链体系。在工业检测领域：随着智能制造加速推进，机器视觉作为工业检测的核心技术支撑，在多领域需求持续释放。公司聚焦SMT环节标准化检、智能终端智能穿戴全检环节、AI服务器、光模块、半导体封装等多领域检测需求，推动产品在多场景落地应用，技术与业务协同推进。积极拥抱出海趋势：公司专注于全球化交付与新兴场景拓展，已在越南设立全资子公司，为客户提供研发、制造、售后全方位本土化服务；并在印度、墨西哥、土耳其、波兰、马来西亚、泰国等国家构建全球化服务网络，建立设备DEMO中心和售后服务体系。
- **半导体业务围绕功率布局绑定大客户进入放量周期，切入先进封装业务前景未来可期。**全球半导体封装设备市场在AI与新能源驱动下持续扩容，据SEMI预测，2025年全球封装设备销售额将增长7.7%，达到54亿美元。2026年，后端设备领域扩张势头将继续，测试设备销售额预计增长5.0%，封装设备销售额预计增长15.0%，实现连续三年增长。公司碳化硅和分立器件封装设备实现头部客户突破，先后获得汇川、中车、比亚迪、成都先进功率半导体、安世、扬杰、长晶浦联等头部分立器件企业展开合作。公司积极切入CoWos先进封装领域，TCB设备研发进展顺利，预计2025年内完成研发并启动客户打样，前景未来可期。
- **风险提示：**新产品拓展不及预期风险；行业景气度波动风险；其他风险。

我们预计2025-2027年公司实现营收11.51、13.28、14.91亿元，实现归母净利润2.67、3.15、3.81亿元，对应PE 31.09、26.44、21.85x，维持公司“买入”评级。

■ 盈利预测和财务指标

	2024A	2025E	2026E	2027E
营业收入（百万元）	945	1,151	1,328	1,491
营业收入增长率(%)	19.24%	21.74%	15.43%	12.24%
归母净利（百万元）	212	267	315	381
净利润增长率(%)	11.10%	26.02%	17.61%	21.00%
摊薄每股收益（元）	0.85	1.05	1.24	1.50
市盈率（PE）	27.08	31.09	26.44	21.85

资料来源：携宁，太平洋证券，注：摊薄每股收益按最新总股本计算

目录

- 1、焊接设备细分龙头，扩展产品品类及应用布局
- 2、受益3C产品创新、自动化、出海趋势，助力主业实现高速增长
- 3、半导体业务围绕功率布局绑定大客户进入放量周期

焊接设备细分龙头，扩展产品品类 及应用布局

1.1 深耕智能装联精密焊接，“专精特新”小巨人

图表1：公司经历多年发展底蕴实力深厚



资料来源：公司官网，太平洋证券

► **持续深耕精密电子组装和半导体封装领域，依托技术创新与产业协同布局新赛道。**公司创立于1993年，是一家专业的智能装备供应商，致力于为精密电子组装&半导体封装领域提供成套装备解决方案，公司的主要产品包括：智能制造成套设备、精密焊接装联设备、机器视觉制程设备、固晶键合封装设备。聚焦半导体封装、新能源汽车电动化和智能化、智能终端智能穿戴、精密电子（医疗电子、数据通信）等多个行业应用领域，持续创新为客户提供专业的解决方案，推动工业数字化、智能化升级。

1.1 深耕智能装联精密焊接，“专精特新”小巨人

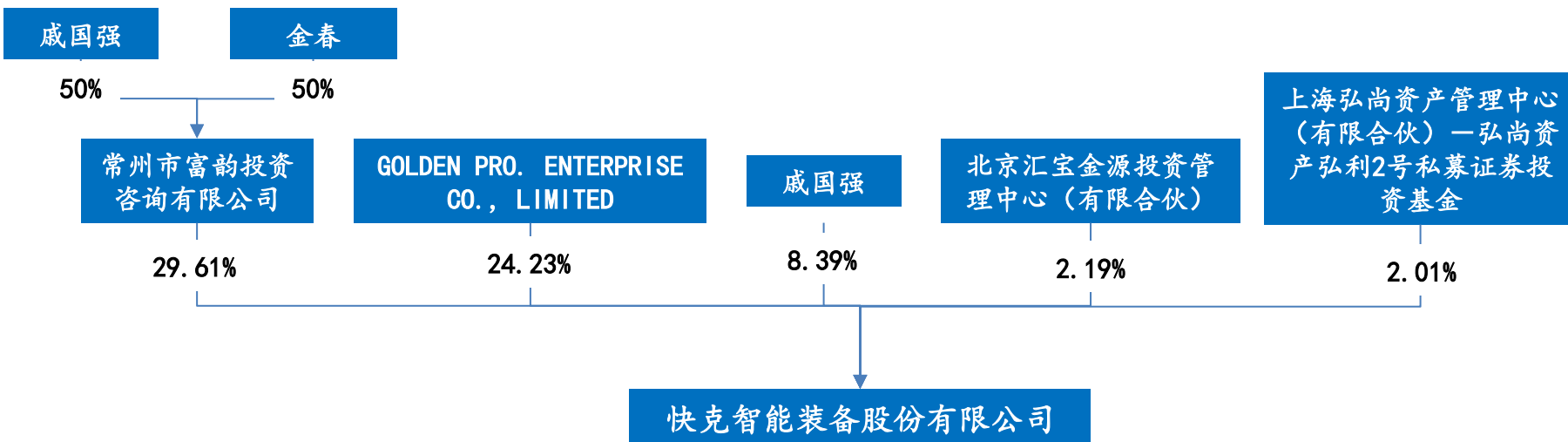
图表2：公司业务



资料来源：公司公告，太平洋证券

1.2 股权结构稳定，管理团队底蕴深厚

图表3：公司前五大股东结构



资料来源：iFinD，太平洋证券

► **股权结构稳定，管理团队技术底蕴深厚。**公司实控人为金春和戚国强，直接或间接持有的股份合计占公司总股本63.35%。金春女士与戚国强先生均毕业于上海科学技术大学，其中，金春女士负责公司整体的战略运营，戚国强先生负责产品的技术研发，实控人的专业技术背景有利于企业长期经营。

1.2 股权结构稳定，管理团队底蕴深厚

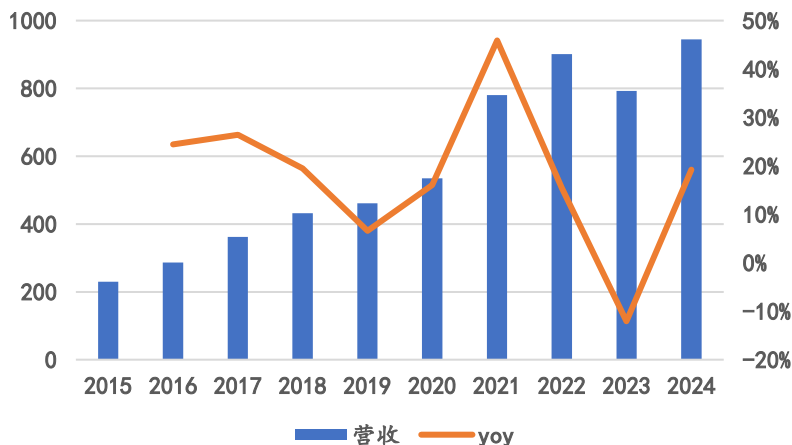
图表4：公司董监高简介

姓名	简介
金春	上海科学技术大学物理系半导体物理与器件学士学位；中欧国际工商学院工商管理 硕士学位。曾任常州速骏电子有限公司（快克智能的前身）董事长。现任快克智能董 事长，兼任快克创业投资有限公司执行董事、零壹半导体技术（常州）有限公司董 事。
戚国强	上海科学技术大学无线电电子学系无线电技术学士学位，高级工程师，科技部科技 创新创业人才。曾任常州市武进快克电子设备厂厂 长、快克电子设备有限公司总经 理、常州速骏电子有限公司（快克智能的前身）任执行董事和总经理。现任快克智能 董事和总经理、快克芯装备执行董事。
刘志宏	澳门城市大学工商管理硕士学位。曾任常州托普电子有限公司业务员、常州市武进 快克电子设备厂业务员、常州市快克电子设备有限 公司销售经理、常州速骏电子有 限公司（快克智能的前身）董事、副总经理。现任快克智能董事和副总经理，兼任康 耐威（苏州） 半导体科技有限公司执行董事、苏州恩欧西智能科技有限公司执行董 事、常州奕瑞自动化设备有限公司执行董事、南京奕瑞软件技术 有限公司执行董事 和总经理、常州快克云商科技有限公司监事、快克技术日本株式会社董事。
窦小明	东南大学电子工程系真空技术及设备专业工学学士学位。曾任常州市钟表总厂（后 更名为常州康常电子计时器有限公司）工程师、常 州市武进快克电子设备厂工程师、 常州市快克电子设备有限公司技术主管、常州速骏电子有限公司（快克智能的前身） 任技术主管。 现任快克智能董事和副总经理。
盛凯	曾任常州第一电子仪器厂工程师、常州市武进快克电子设备厂工程师、常州市快克 电子设备有限公司技术主管、常州速骏电子有限公司（快克智能的前身）技术主管。现任江苏快克芯装备科技有限公司监事、快克智能技术管理部总监、监事会主席和职工监事。
黎杰	河海大学国际经济与贸易专业学士学位。曾任无锡荣齐服饰有限公司采购员、常州 市快克电子设备有限公司外贸业务员、常州速骏电 子有限公司（快克智能的前身） 外贸业务员。现任快克智能外贸业务员和监事。
王中赞	曾任常州第七无线电厂车间主管、常州市武进快克电子设备厂生产主管、常州市快 克电子设备有限公司生产主管、常州速骏电子有限 公司（快克智能的前身）生产主 管。现任快克智能 PMC 经理和监事。
蒋素蕾	南京信息工程大学会计学学士学位。曾任中航证券有限公司经理、快克智能证券事 务代表，现任快克智能董事会秘书，兼任快克创业 投资有限公司总经理。

资料来源：公司公告，太平洋证券

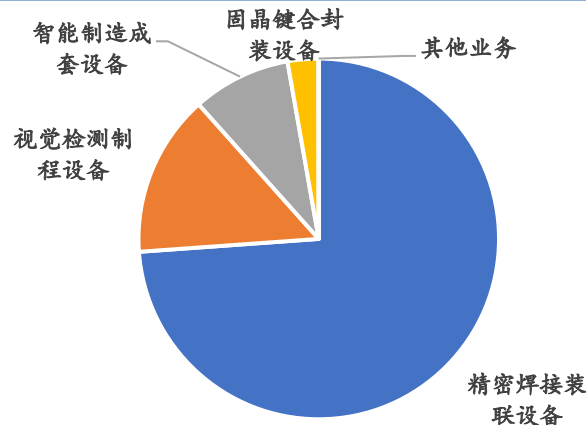
1.3 坚持多元发展，业绩稳步向上

图表5：公司营收变化（亿元）



资料来源：iFind，太平洋证券

图表6：公司2024年营收结构

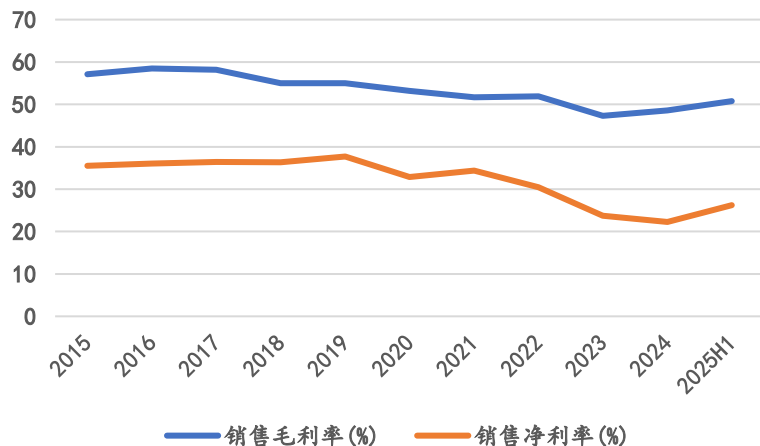


资料来源：iFind，太平洋证券

► **拥抱AI市场机会，公司发展进入发展快车道。**公司2015-2024年营收由2.30亿元增长至9.45亿元，CAGR高达17.00%，其中2023年受消费电子行业复苏疲软影响，业绩短期承压，营收7.93亿元，同比减少12.07%。2024年开始，公司积极把握AI智能硬件产品带来的市场机会，加大技术创新和国际化布局，深度布局AI人工智能、智能穿戴、半导体封装、新能源汽车及储能、机器人电子元件等战略赛道，精密焊接装联设备和AOI机器视觉设备实现增长。

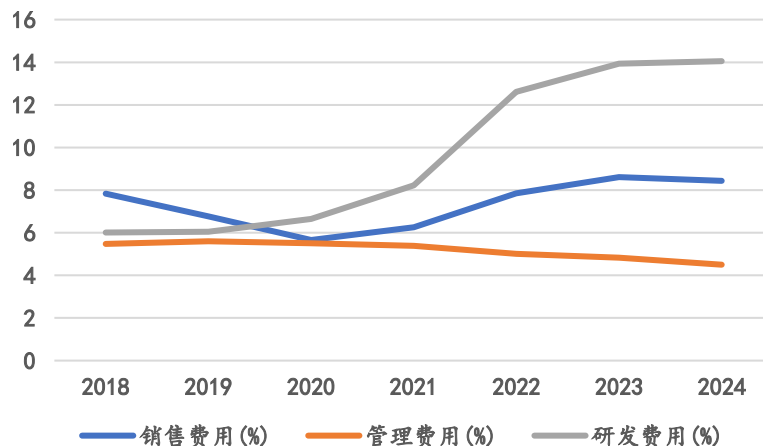
1.3 坚持多元发展，业绩稳步向上

图表7：公司毛利率及净利率变化



资料来源：iFind，太平洋证券

图表8：公司三费情况



资料来源：iFind，太平洋证券

- 历史盈利能力相对较强，2025H1毛利率企稳回升。**公司历史盈利能力相对稳健，2015-2022年毛利率始终维持在50%以上高位运行。2023年受下游消费电子行业景气度波动影响，毛利率略有承压，但随着公司近两年开始坚持多元化发展，扩展产品品类及应用布局，公司整体盈利能力与运营效率稳步提升。
- 重视研发投入，构建技术平台研发&行业应用开发。**2018-2024年，公司销售费用率从7.83%升至8.43%、管理费用率从5.48%降至4.50%。公司研发投入持续增加，由2018年的0.26亿元增长至2024年的1.33亿元。2022-2024年，公司研发费用率始终保持在10%以上。

受益3C产品创新、自动化、出海趋势，助力主业实现高速增长

2.1 消费电子AI化进程显著加速，驱动精密焊接需求升级

图表9：AI手机渗透率提升加快



资料来源: Canalis, 太平洋证券

图表10：公司精密焊接装联设备产品



资料来源: 公司公告, 太平洋证券

➤ **消费电子AI化浪潮驱动精密焊接需求升级。**据Canalys预测，2025年AI手机的市场渗透率预计将达到34%。随着端侧模型的不断优化以及芯片运算能力的提升，AI手机正逐步向中端价位市场扩展。2025H1，公司精准把握AI消费电子结构升级机遇，技术创新与业务拓展同步突破。针对AI终端开发的震镜激光焊设备，凭借高速高效优势，已应用于Meta智能眼镜批量生产场景；依托激光热压、激光锡环焊及AOI检测等核心工艺，成功切入小米、OPPO、vivo等头部企业的智能手机及智能穿戴设备供应链。同时，公司的PCB激光分板技术实现重要突破，相关设备已进入富士康、立讯等企业，形成超千万量级订单规模。

2.2 AI服务器市场爆发，带动高速连接器焊接和精密组装设备需求增长

图表11：全球AI服务器市场规模（十亿美元）



资料来源：TrendForce，太平洋证券

图表12：莫仕推出芯片互连224G高速产品

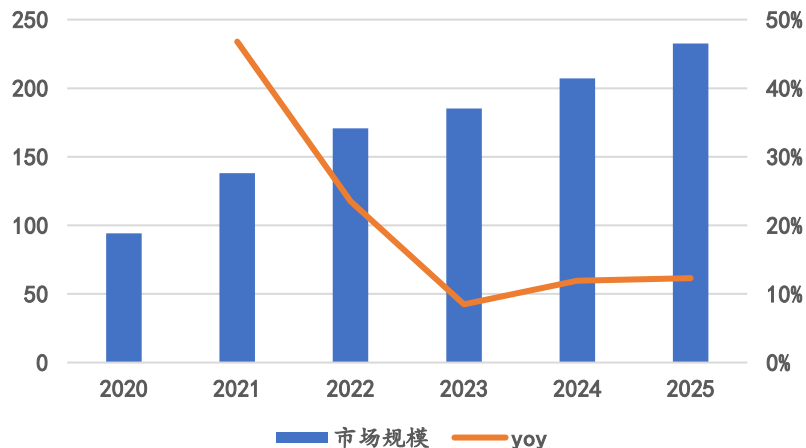


资料来源：讯石光通讯网，太平洋证券

▶ **AI 服务器市场爆发式增长带动高速连接器需求激增。**据TrendForce统计，2024年AI服务器行业价值约2050亿美元，展望2025年，由于需求持续旺盛且产品平均售价较高，预计AI服务器细分市场的价值将升至2980亿美元。公司高速连接器焊接设备已进入多家英伟达核心供应商，持续为莫仕等连接器供应商提供精密电子组装设备。公司在这一高速增长赛道的突破，将为未来业绩增长注入强劲动力。

2.3 全场景检测能力升级，AI服务器与光模块领域取得进展

图表13：中国机器视觉市场规模（亿元）



资料来源：中商产业研究院，太平洋证券

图表14：公司机器视觉制程设备产品



资料来源：公司公告，太平洋证券

➤ **机器视觉作为工业检测的核心技术支撑，在多领域需求持续释放。**据中商产业研究院统计，2024年中国机器视觉市场规模为207.17亿元，近五年CAGR达21.80%，2025年中国机器视觉市场规模将达到232.65亿元。从全球范围来看，据Markets and Markets预测，到2030年全球机器视觉市场规模将从2025年的158.3亿美元增长到236.3亿美元，CAGR为8.3%。在应用领域方面，3C电子、汽车电子、半导体封装依旧是主要应用场景，同时新兴领域如光模块和AI服务器增长势头迅猛，对精密检测设备需求显著增加，公司聚焦各领域检测需求，推动产品在多场景落地应用，技术与业务协同推进。

2.4 落地国际化战略，加速全球化布局与新兴领域渗透

图表15：公司携多款半导体封装设备亮相两大国际展会



资料来源：公司新闻，太平洋证券

图表16：公司固晶键合封装装备取得较大进展



资料来源：公司新闻，太平洋证券

► **公司营销中心管理全球业务。**公司海外业务以通用设备经销商服务为主，同时对全球化大客户提供直接的装备和自动化产线交付。公司已在越南设立全资子公司，为客户提供研发、制造、售后全方位本土化服务；在印度、墨西哥、土耳其、波兰、马来西亚、泰国等国家构建全球化服务网络，建立设备DEMO中心和售后服务体系。公司TCB设备研发进展顺利，预计年内完成研发并启动客户打样，助力先进封装关键设备国产化。

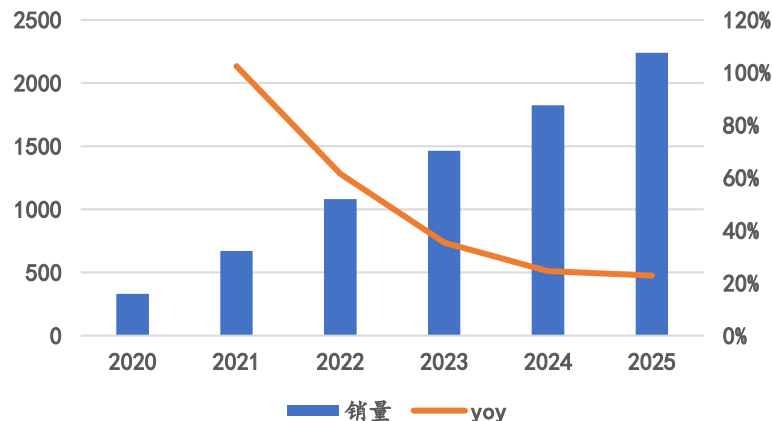
2.5 全球化交付与新兴场景拓展，智能制造成套装备构筑新增长极

图表17：公司智能制造成套装备产品



资料来源：公司公告，太平洋证券

图表18：全球新能源汽车销量预测



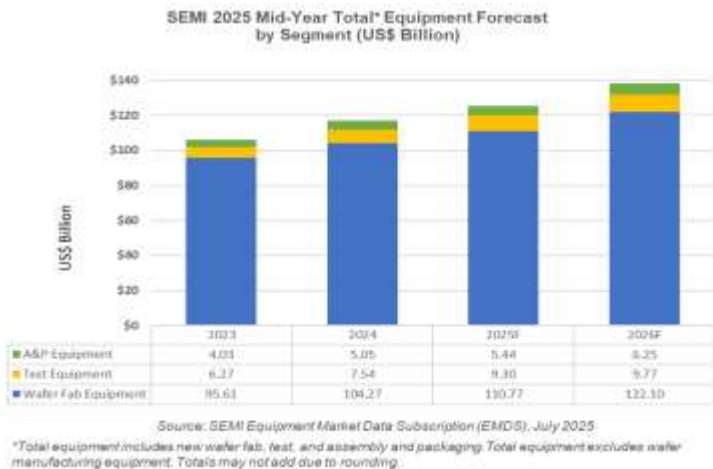
资料来源：EVTank，太平洋证券

- ▶ **以核心客户合作为根基，加速全球化布局与新兴领域渗透。**公司在核心客户合作方面，与博世集团合作深度升级，2025年承接了包括行车记录仪及域控制器等自动化项目；全球化布局实现关键突破，向佛吉亚等欧洲生产基地成功交付线控底盘ESC产线及座舱域多媒体控制器VCC产线。
- ▶ **以核心工艺能力驱动自动化产线落地线控底盘、激光雷达及服务器液冷等新兴领域。**在线控底盘领域，公司为伯特利提供线控制动One-box自动化整线；在激光雷达领域，为禾赛科技交付多条精密激光焊接及检测自动化线体；在AI服务器液冷领域，公司为飞龙股份交付散热水泵自动化生产线，受益于AI服务器市场爆发式增长，相关配套产线已实现复购，成为业务增长核心驱动力。

半导体业务围绕功率布局绑定大客户进入 放量周期

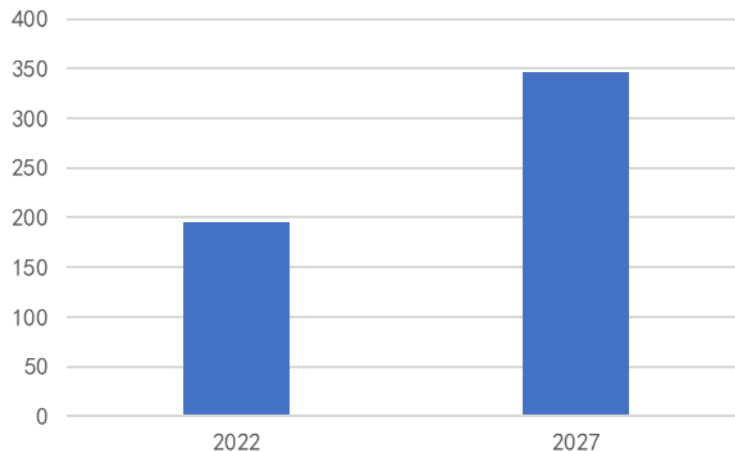
3.1 全球半导体封装设备市场在AI与新能源驱动下持续扩容

图表19：全球半导体设备销售额预测



资料来源：SEMI，太平洋证券

图表20：AI服务器市场规模（亿美元）



资料来源：IDC，太平洋证券

▶ **全球半导体封装设备市场在AI与新能源驱动下持续扩容。**据SEMI预测，2024年全球封装设备销售额增长25.4%，2025年预计将再增长7.7%，达到54亿美元。2026年，后端设备领域扩张势头将继续，测试设备销售额预计增长5.0%，封装设备销售额预计增长15.0%，实现连续三年增长。这一增长主要受设备架构复杂性显著提升，以及AI和高带宽存储器（HBM）半导体对高性能的强劲需求推动。

3.2 碳化硅和分立器件封装设备实现头部客户突破

图表21：公司银烧结设备广泛应用于功率半导体及新能源汽车领域

图表22：公司半导体设备部分大客户



资料来源：公司官网，太平洋证券

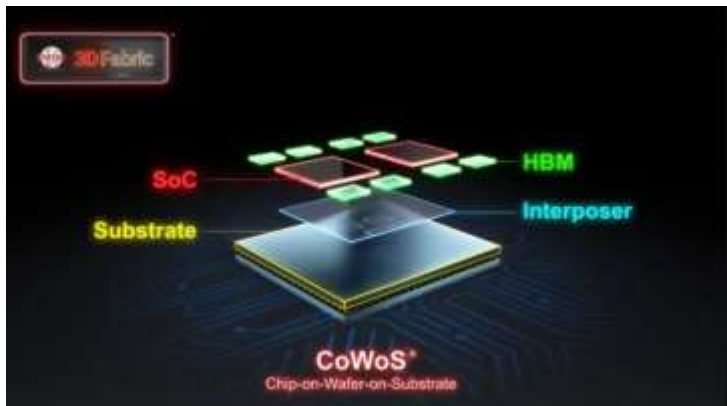
资料来源：各公司官网，太平洋证券

► **碳化硅和分立器件封装设备实现头部客户突破。**公司的碳化硅微纳银（铜）烧结设备获得汇川、中车、比亚迪等设备订单；高速高精固晶机斩获成都先进功率半导体批量订单并开始和安世、扬杰、长晶浦联等头部分立器件企业展开合作；多功能固晶机、热贴固晶机技术成熟度显著提升，正在和微纳银（铜）烧结设备、甲酸/真空焊接炉、芯片检测AOI形成封装成套方案解决能力。

3.3 面向COWOS积极布局封装设备，热压键合（TCB）设备研发取得关键进展

图表23：公司针对AI、高性能计算开发TCB设备

图表24：CoWoS封装技术凭借独特优势迅速崛起



资料来源：公司官网，太平洋证券

资料来源：台积电官网，太平洋证券

➤ **积极切入先进半导体封装，业务前景可期。**作为AI芯片 CoWoS、HBM封装的核心工艺设备，TCB在微米级互连中发挥关键作用，Yole预测2030年热压键合市场达9.36亿美元。公司积极切入CoWoS先进封装领域，TCB设备研发进展顺利，预计2025年内完成研发并启动客户打样，助力先进封装关键设备国产化，业务前景未来可期。

3.3 面向COWOS积极布局封装设备，热压键合（TCB）设备研发取得关键进展

图表24：公司产品线布局丰富

焊接装联	视觉AOI	智能终端/智能穿戴	新能源	半导体
焊接工具设备	3D AOI & 3D SPI	模组	ADAS毫米波雷达	热压键合固晶机 (TCB)
选择性波峰焊	芯片封装AOI	智能终端	智能线控底盘	高速高精固晶机
激光焊接		元宇宙	热管理系统	热贴固晶机
FPC热压焊			ECU	多功能固晶机
焊接附件装联				银烧结设备
精密点胶				真空焊接设备
激光打标				甲酸焊接炉
				芯片封装AOI
				功率器件封装解决方案

资料来源：公司官网，太平洋证券

盈利预测

我们预计2025-2027年公司实现营收11.51、13.28、14.91亿元，实现归母净利润2.67、3.15、3.81亿元，对应PE 31.09、26.44、21.85x，维持公司“买入”评级。

■ 盈利预测和财务指标

	2024A	2025E	2026E	2027E
营业收入（百万元）	945	1,151	1,328	1,491
营业收入增长率(%)	19.24%	21.74%	15.43%	12.24%
归母净利（百万元）	212	267	315	381
净利润增长率(%)	11.10%	26.02%	17.61%	21.00%
摊薄每股收益（元）	0.85	1.05	1.24	1.50
市盈率（PE）	27.08	31.09	26.44	21.85

资料来源：携宁，太平洋证券，注：摊薄每股收益按最新总股本计算

风险提示

风险提示

- 新产品拓展不及预期风险；
- 行业景气度波动风险；
- 其他风险。

预测明细

资产负债表 (百万)

	2023A	2024A	2025E	2026E	2027E
货币资金	154	182	230	281	355
应收和预付款项	257	373	415	486	549
存货	227	315	341	397	438
其他流动资产	668	559	557	560	564
流动资产合计	1,307	1,429	1,542	1,724	1,906
长期股权投资	0	0	0	0	0
投资性房地产	11	11	11	11	11
固定资产	102	146	127	109	91
在建工程	44	115	115	115	115
无形资产开发支出	47	45	45	45	45
长期待摊费用	11	18	18	18	18
其他非流动资产	1,562	1,679	1,790	1,972	2,154
资产总计	1,778	2,014	2,107	2,270	2,434
短期借款	5	4	4	4	4
应付和预收款项	197	380	369	435	487
长期借款	0	0	0	0	0
其他负债	177	194	232	257	281
负债合计	380	578	605	695	772
股本	251	249	254	254	254
资本公积	400	387	387	387	387
留存收益	737	800	864	939	1,031
归母公司股东权益	1,374	1,416	1,483	1,559	1,650
少数股东权益	25	20	18	15	12
股东权益合计	1,399	1,436	1,502	1,574	1,662
负债和股东权益	1,778	2,014	2,107	2,270	2,434

现金流量表 (百万)

	2023A	2024A	2025E	2026E	2027E
经营性现金流	210	141	226	263	332
投资性现金流	-85	75	24	28	31
融资性现金流	-245	-189	-201	-239	-289
现金增加额	-125	28	48	51	74

资料来源: 携宁, 太平洋证券

利润表 (百万)

	2023A	2024A	2025E	2026E	2027E
营业收入	793	945	1,151	1,328	1,491
营业成本	418	486	581	661	725
营业税金及附加	7	10	13	15	16
销售费用	68	80	94	109	122
管理费用	38	42	52	60	67
财务费用	-12	-5	11	16	3
资产减值损失	-4	-10	0	0	0
投资收益	19	18	24	28	31
公允价值变动	0	2	0	0	0
营业利润	204	235	296	348	421
其他非经营损益	0	0	0	0	0
利润总额	204	235	296	348	421
所得税	16	25	31	36	44
净利润	188	210	265	312	377
少数股东损益	-3	-2	-2	-3	-3
归母股东净利润	191	212	267	315	381

预测指标

	2023A	2024A	2025E	2026E	2027E
毛利率	47.30%	48.57%	49.54%	50.21%	51.34%
销售净利率	24.10%	22.45%	23.24%	23.68%	25.53%
销售收入增长率	-12.07%	19.24%	21.74%	15.43%	12.24%
EBIT 增长率	-30.65%	24.38%	42.60%	18.51%	16.64%
净利润增长率	-30.13%	11.10%	26.02%	17.61%	21.00%
ROE	13.91%	14.99%	18.03%	20.17%	23.06%
ROA	10.30%	11.10%	12.87%	14.24%	16.04%
ROIC	11.34%	13.35%	18.21%	20.59%	22.75%
EPS (X)	0.77	0.85	1.05	1.24	1.50
PE (X)	37.55	27.08	31.09	26.44	21.85
PB (X)	5.27	4.05	5.61	5.33	5.04
PS (X)	9.14	6.07	7.23	6.26	5.58
EV/EBITDA (X)	36.48	23.45	24.90	21.06	18.01

投资评级说明

1、行业评级

看好：预计未来6个月内，行业整体回报高于沪深300指数5%以上；

中性：预计未来6个月内，行业整体回报介于沪深300指数-5%与5%之间；

看淡：预计未来6个月内，行业整体回报低于沪深300指数5%以下。

2、公司评级

买入：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅在15%以上；

增持：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于5%与15%之间；

持有：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于-5%与5%之间；

减持：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于-5%与-15%之间；

卖出：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅低于-15%以下。

太平洋证券股份有限公司

云南省昆明市盘龙区北京路926号同德广场写字楼31楼



投诉电话： 95397

投诉邮箱： kefu@tpyzq.com

免责声明

太平洋证券股份有限公司（以下简称“我公司”或“太平洋证券”）具备中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告仅向与太平洋证券签署服务协议的签约客户发布，为太平洋证券签约客户的专属研究产品，若您并非太平洋证券签约客户，请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息；太平洋证券不会因接收人收到、阅读或关注媒体推送本报告中的内容而视其为太平洋证券的客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何机构和个人的投资建议，投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映研究人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告，视为同意以上声明。